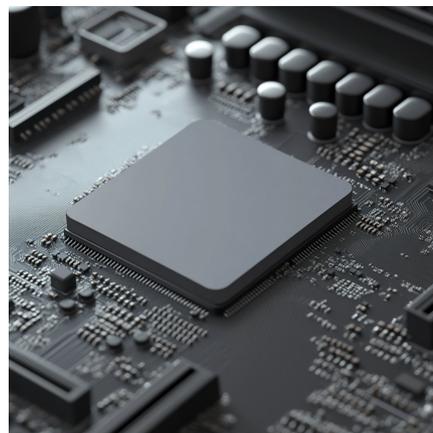


CPU Thermal Pad

Découvrez la prochaine génération de dissipation thermique avec notre CPU Thermal Pad de haute qualité !

Conçu pour les joueurs exigeants et les passionnés de technologie, ce pad s'installe en un clin d'œil, sans bavures ni taches.

Il suffit de l'appliquer, de placer le processeur et le tour est joué ! Le pad garantit un transfert de chaleur optimal tout en préservant le précieux matériel.



Points forts du produit

- Pas de bavures ni d'application compliquée - il suffit de placer et de commencer
- Pas besoin de repasser la peinture au pinceau - économie de temps et d'énergie
- Idéal pour les configurations de jeu et les systèmes puissants
- Protège l'unité centrale de manière fiable sans l'endommager
- Haute performance pour la conduction de la chaleur - aussi pour les sessions de jeu

Données techniques

Contenu	15% Hydrocarbon, 85% Inorganic filler
Conductivité thermique	22.5±0.1W/m-K
Impédance thermique	<0.011°C-in2/W
Résistance thermique	0.29K/W
Densité	2.6g/cc
Dicke	0.25-0.3mm
Température stockée	-50~250°C
Température de travail	-40~125°C

Données logistiques **38 x 38 x 0.25mm**

Numéro d'article	XZ028
Numéro de fabricant	XPTP.P
EAN Barcode	4044953504235

Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives. Sauf erreur.
Sujet à changement sans préavis. Les images peuvent différer du produit original.



09.05.2025